

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-25

中国天楹股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款情况概述

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）间接全资子公司香港楹展投资有限公司（以下简称“香港楹展”、“借款人”）近日与德意志银行新加坡分行作为委任牵头安排行及簿记行的银团（以下称“银团”）签署了《贷款协议》（以下称“《银团贷款协议》”），约定银团向香港楹展提供一笔金额不超过 35,000 万欧元的贷款，用于支付公司向江苏德展投资有限公司原股东进行股权收购的现金对价及补充公司营运资金等。

2019 年 3 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》，同意以全资子公司江苏德展投资有限公司、香港楹展投资有限公司为主体，向银行申请总额不超过 5 亿欧元的银行贷款（最终贷款额度以与银行签署的贷款协议为准）。

二、借款人基本情况

借款人名称：香港楹展投资有限公司

成立日期：2016 年 1 月 7 日

注册地点：402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
(香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 402 室)

董事：严圣军

注册资本：1,130,065,434.63 欧元

经营范围：实业投资、股权投资以及能源项目投资

与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2018年11月30日 (未经审计)	2018年4月30日 (经审计)
资产总额	848,264.86	842,431.27
负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)	2.37	2.30
净资产	848,262.49	842,428.97
	2018年11月30日 (未经审计)	2018年4月30日 (经审计)
营业收入		
利润总额	-270.42	-175.19
净利润	-270.42	-175.19

借款人信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、《银团贷款协议》的主要内容

- 1、借款金额：本次借款本金总金额不超过 35000 万欧元。
- 2、借款期限：自首次提款日起 3 年。
- 3、利息支付：每笔贷款的利息应于该笔贷款的每个利息期最后一日及该贷款的终止日支付。
- 4、担保方式：公司提供保证担保、公司部分全资子公司的股权质押、账户质押等。

四、本次借款对公司的影响

公司全资子公司香港楹展的本次借款，主要用于公司发行股份及支付现金购买资产之现金对价的支付安排，符合公司的发展需求，有利于缓解公司资金压力，上述借款事项不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

中国天楹第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019年4月9日